

# 半導體製程概論與封裝技職班

開課時間：115年7月9日至8月5日

報名截止日：115年6月5日

授課語言：英/西語

4 QUALITY EDUCATION



8 DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH



9 INDUSTRY, INNOVATION AND INFRASTRUCTURE



3

## 訓練簡介

為呼應榮邦八大旗艦計畫之「半導體供應鏈韌性」主軸，協助友邦培育科技產業所需人才，本班課程內容將介紹半導體封測基礎技術，如封裝技術、測試數據判讀等，並安排封測作業模擬操作練習，協助學員掌握從元件基礎到操作應用之關鍵環節。

## 課程安排面向

- 半導體封測基礎及常見封裝技術介紹: 介紹半導體封裝測試整體流程，概述晶圓切割與黏合等基礎技術。並介紹常見封裝技術，如球柵陣列封裝（BGA）與無引腳方形扁平封裝（QFN）的技術特點與應用範疇。
- 測試數據判讀及封測作業模擬操作: 透過實作練習強化學員對封測作業技能掌握，並學習分析測試數據，識別並處理不良產品，以提升產品合格率。
- 半導體產業鏈參訪：安排我國半導體產業鏈上中下游相關企業實地參訪。

## 參訓資格

- 年滿20歲以上，具電機、電子或基礎電路知識，對半導體技術應用有興趣者。

### 課程聯絡人

許禮筠 副管理師

Tel: 886-2-28886090

Fax: 886-2-28766491

E-mail: L.y.hsu@icdf.org.tw

TaiwanICDF School



You  
Tube

A Sneak Peek of  
TaiwanICDF Workshop Program